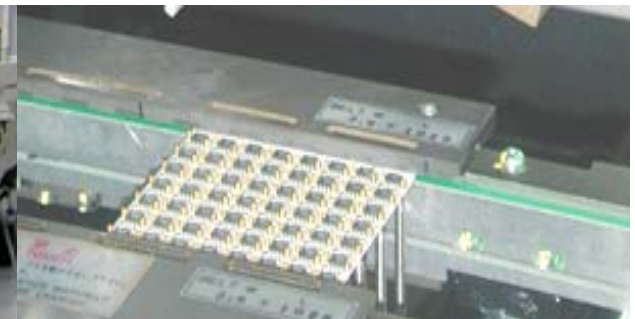




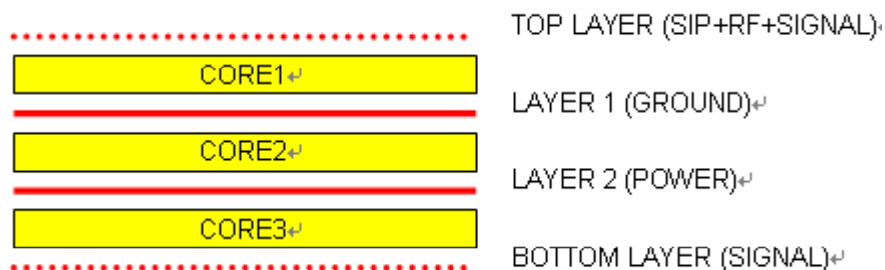
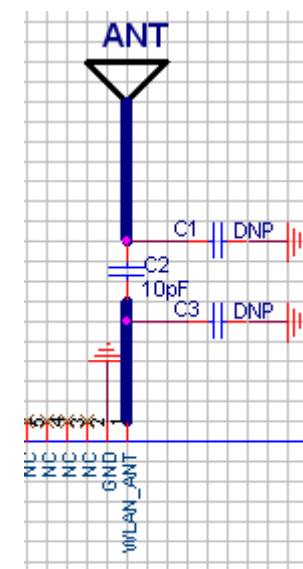
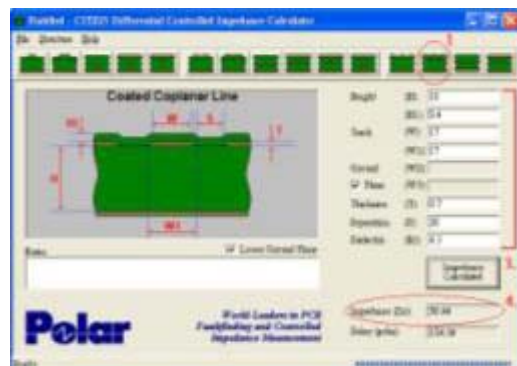
[www.ampak.com.tw](http://www.ampak.com.tw)



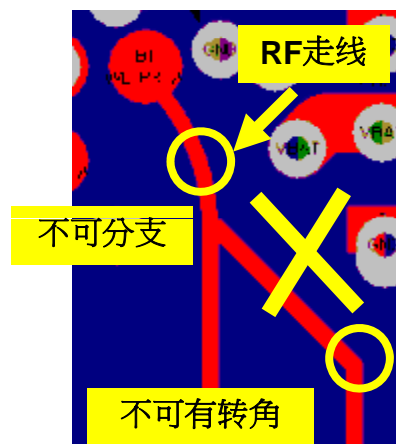
## AMPAK Module Design Guideline 设计指导

## RF 佈线设计指导

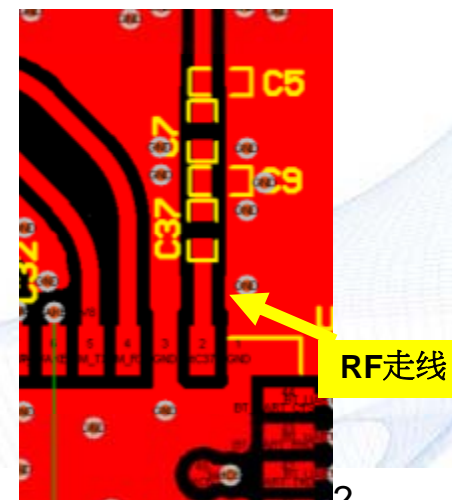
- ❖ RF 布线的宽度设计需考量到线段的阻抗值。其阻抗值需设计至50欧姆附近。（右图为模拟RF布线阻抗的软体画面）
- ❖ RF 布线越长，能量损失越大，因此在RF 布线设计时，路径越短越好。
- ❖ RF 布线上，不能有分支情况发生，如右图所示。
- ❖ RF 布线若有遇到需转向时，不可用转角的方式转向，需用弧形的方式使走线转向，如右图所示。
- ❖ RF 布线下方需有一片完整的金属铺铜作为 RF 讯号的参考地，其板子佈线结构参考设计如下图所示。



不正确的RF layout



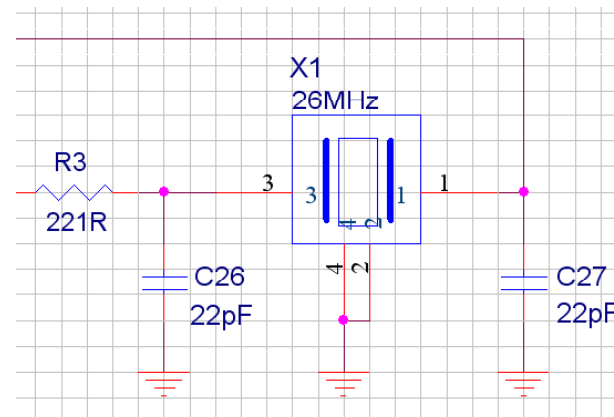
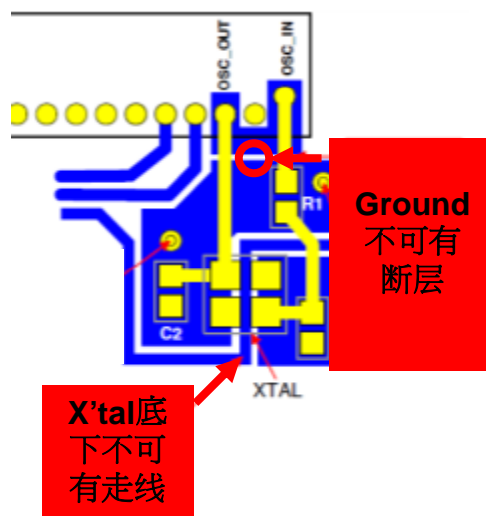
正确的RF layout



- ❖ 请注意搭配晶振所使用到的电容之容值大小 (C26, C27), 若是采用 **26MHz, CL=16pF** 的晶振所搭配的外部匹配电容值需为 **22pF**。

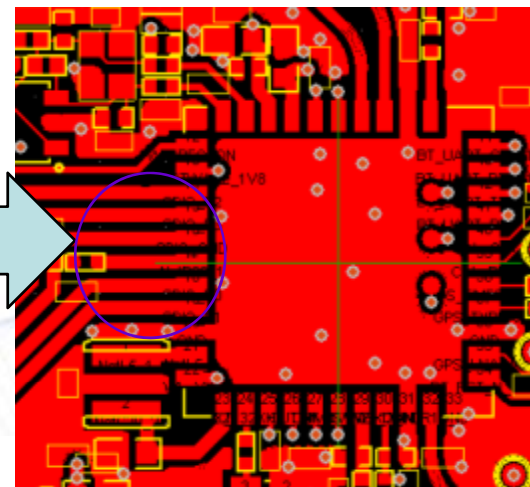
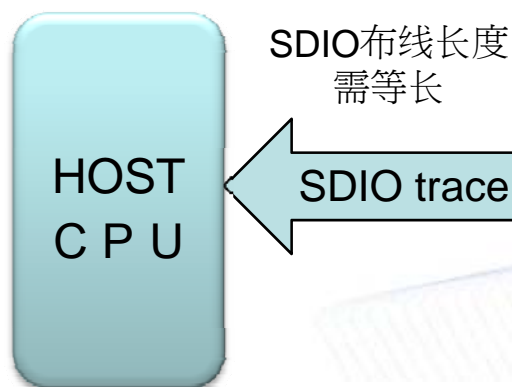
- ❖ 晶振规格, 需注意以下条件

1. Frequency Tolerance < +/- 20ppm
2. ESR < 60 欧姆
3. 26MHz 晶振内部CL值需选用16pF,



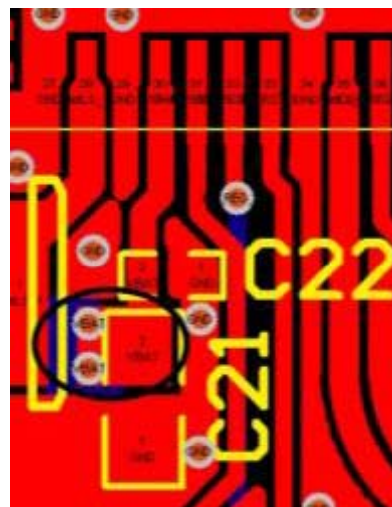
供应商窗口: 北京办事处,  
肖音 Email: [xy@hosonic.com](mailto:xy@hosonic.com)  
+8613693345123, +8618601005439  
东莞/深圳区业务  
李瑤琪 [yaochi.lee@hosonic.com](mailto:yaochi.lee@hosonic.com)  
+8613825735735

- ❖ 连接HOST AP端与模块端之SDIO布线需等长及平行。另外, SDIO布线须避免靠近电源布线或CLK布线。

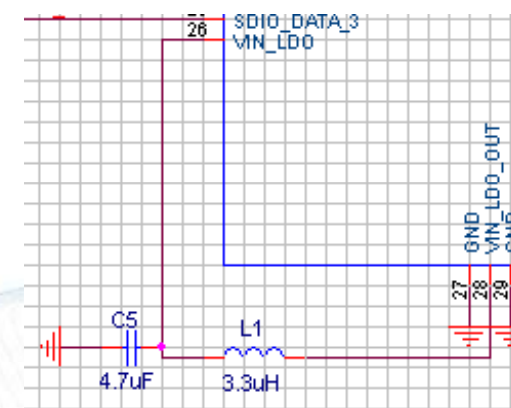
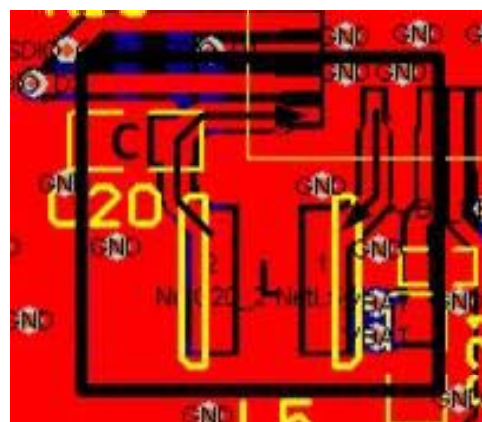


## VBAT

- ❖ 在电源布线方面，请以铺铜之方式来走线，若不行，走线线宽大于14mil。
- ❖ 模块的VBAT与VDDIO的电源脚位至少须有4.7uF的稳压电容靠近模块，电源的稳压电容尽可能与模块摆放至同一层面。如右图所示。
- ❖ 搭配模块所使用的电源电感及电容摆放位置及走线如右图所示。

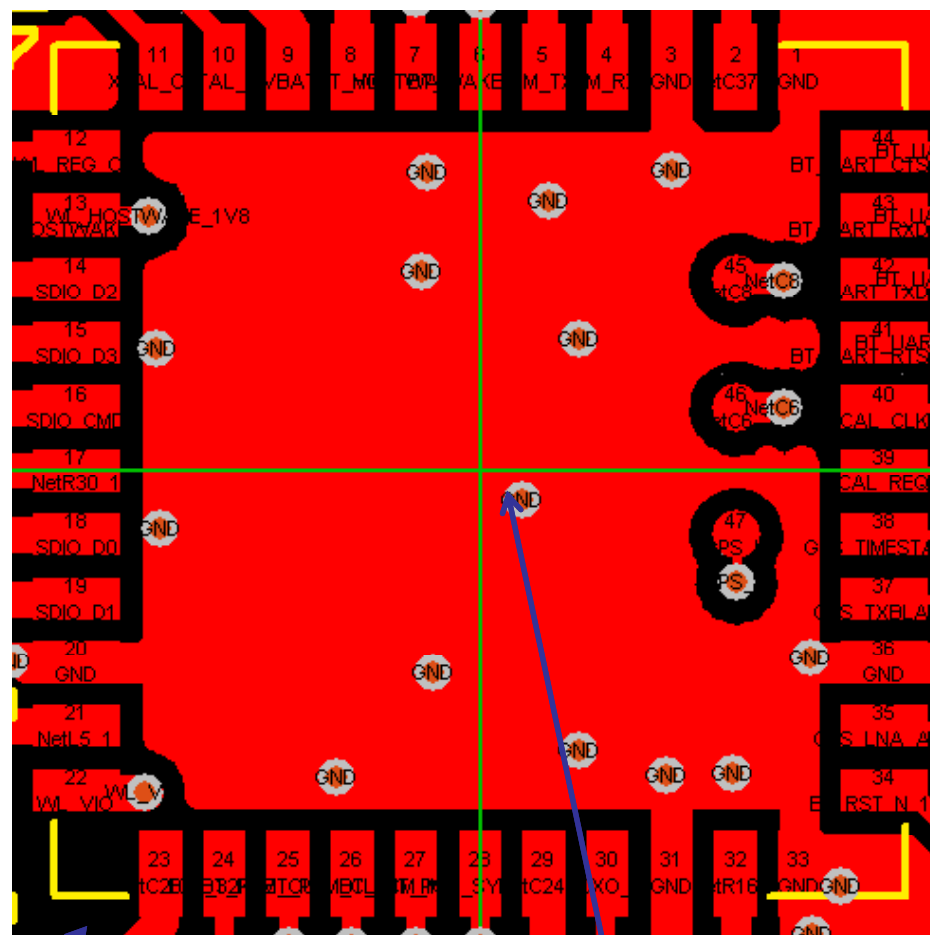


## VDDIO



## 主板的焊盘参考设计

- ❖ A. 模块边框需加上白漆位置做为模块对位的位置, 白漆边框大小为 $12.1 \times 12.1\text{mm}$ 。
- ❖ B. 用机构线标出模块中心坐标和规格书一样中心位置能提供给SMT厂做为模块贴片之对位坐标。



A. 白漆外框

B. 模块中心点坐标



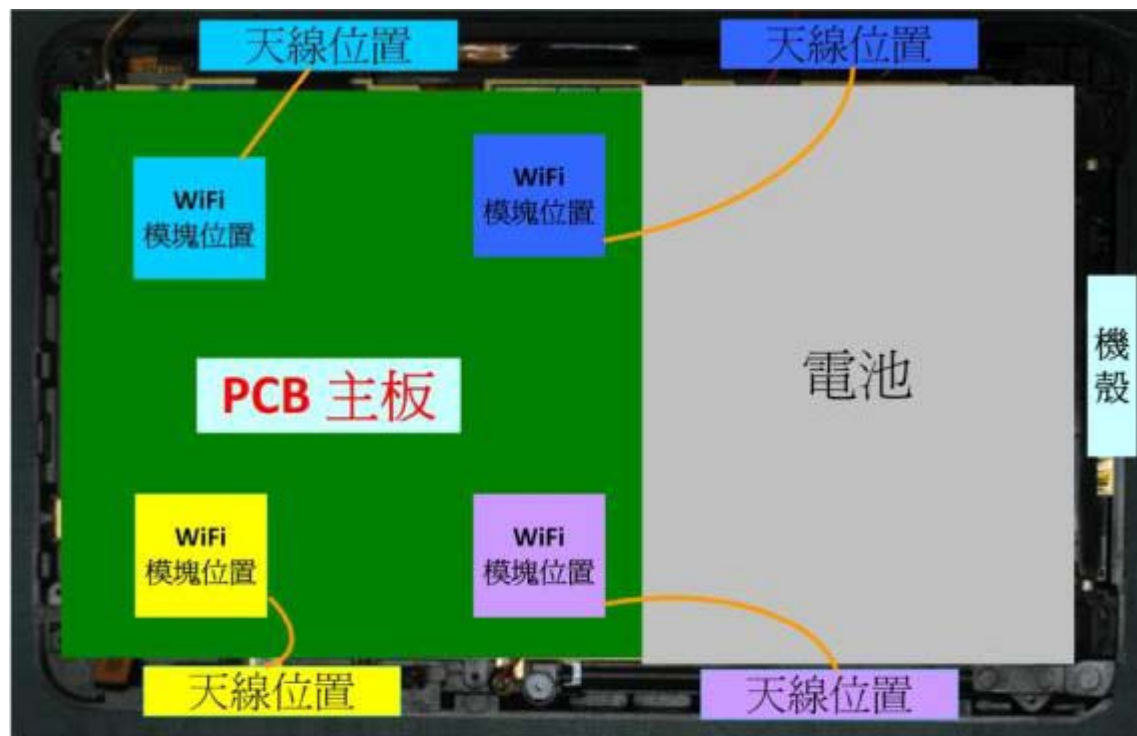
## 天线位置佈局指导

### ❖ 天线设计考量

- 建议天线摆放位置如右图所示意
- 天线本体周遭的金属至少离天线1 cm以上
- 避免使用金属外壳

### ❖ 模块摆放位置:

- 模块摆放如右图所示意之布局位置
- 建议缩短模块的RF输出端与天线之距离



## ❖ 天线需求规格如下表所建议项目：

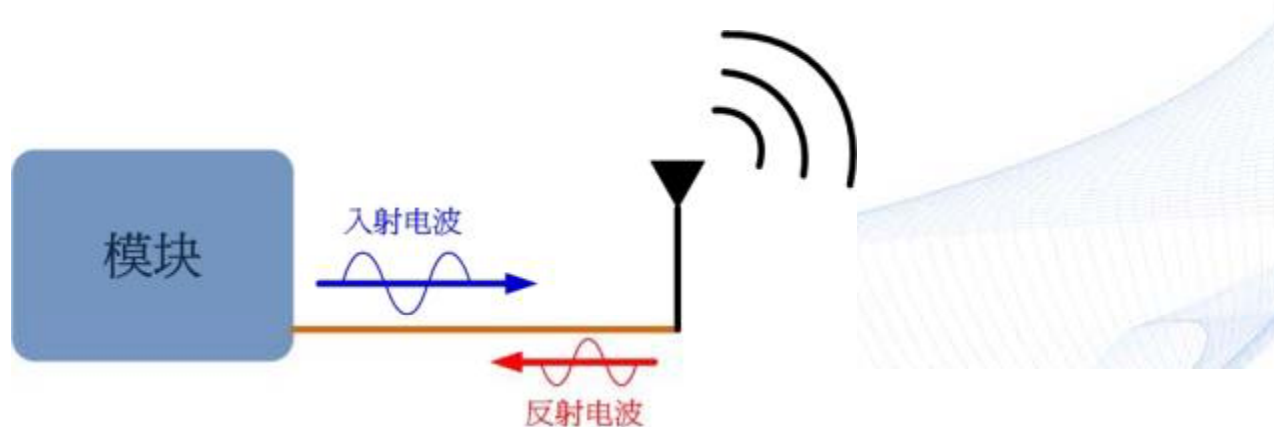
Frequency range	Bandwidth	Impedance	Peak Gain	Efficiency	VSWR	Polarization
操作频段	带宽	天線阻抗	天线阻抗	效率	电压驻波比	极化
2360MHz~2520MHz	>150MHz	50Ohm	>1dBi	> 50%	<2.0	线性极化

## ❖ 天线参数解释说明：

➤ 效率:指天线辐射出去的功率和输入到天线的功率之比。

◆ 范例：当模块输出**16dBm**的的RF能量传输至一个效率为**50%**的天线，则天线辐射出去的总能量只剩**13dBm**。

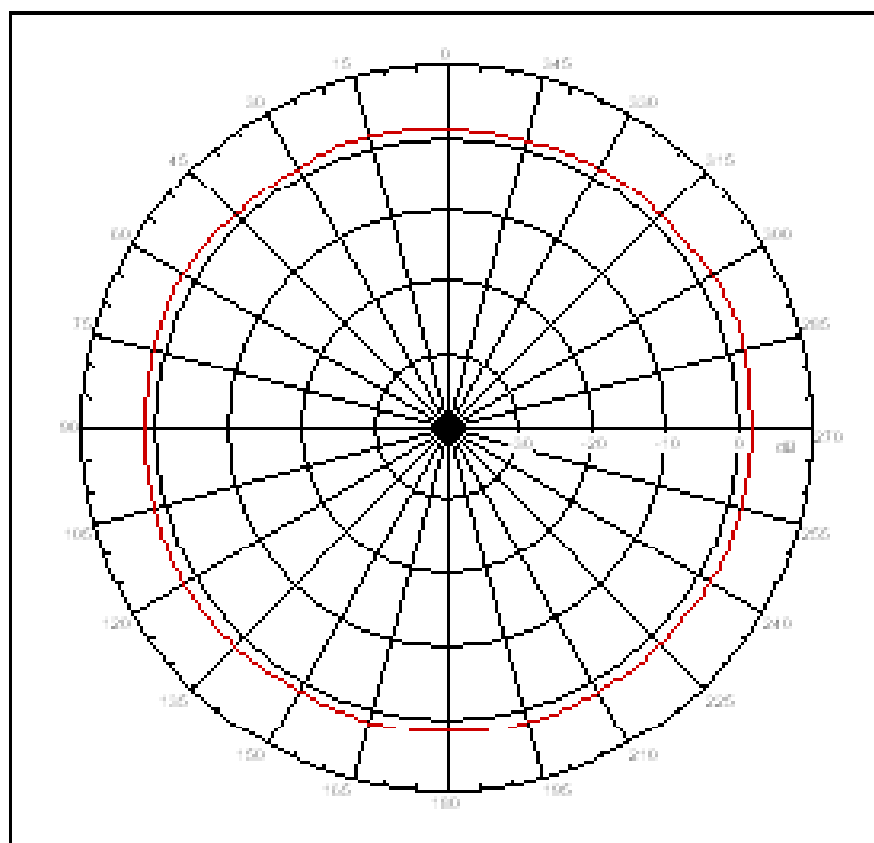
➤ 电压驻波比：RF能量传递至不同的元件时，由于阻抗不同的关系，能量会有一部分被反射。电压驻波比，指的就是入射电波功率跟反射电波功率的比值。因此驻波比越大，代表反射功率就越高，而入射电波功率就越小。



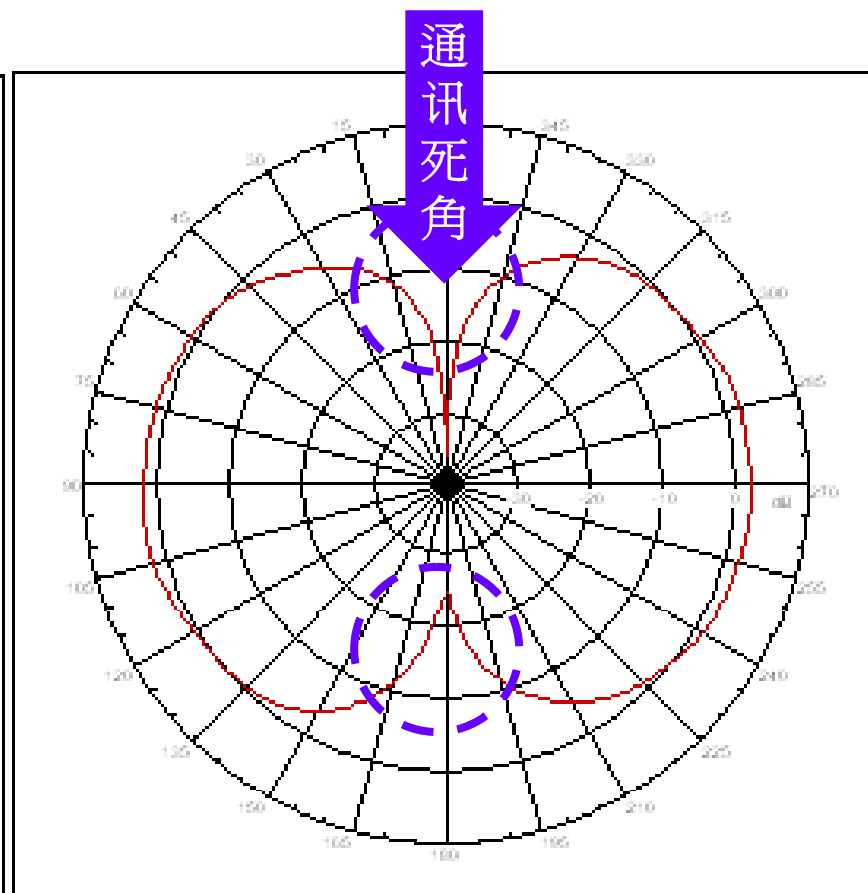
## ❖ 天线参考场型图如下图所示：

- 天线场型图有分为水平平面（H-plane）场型图以及垂直平片（E-plane）场型图，在选用天线时请注意至少有一个平面的天线场型图需近似于圆形。

--目的:避免产品在使用上有通讯死角。



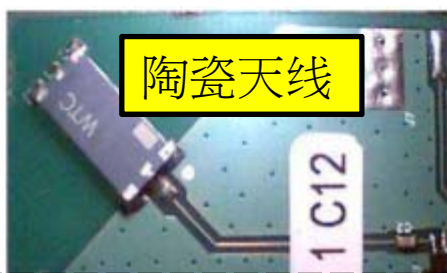
2.45GHz\_H-plane



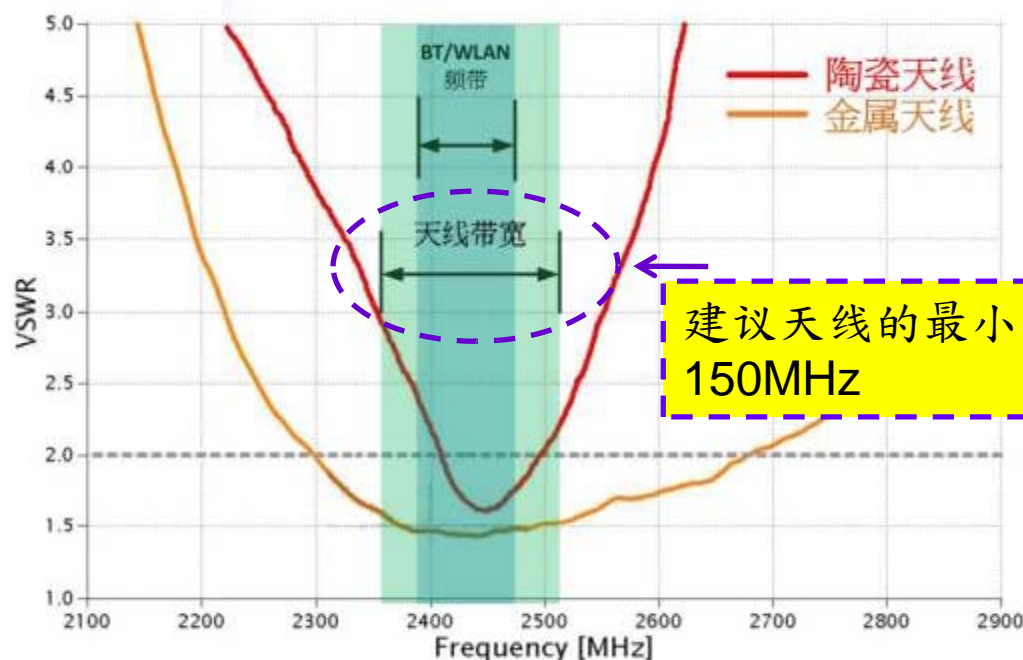
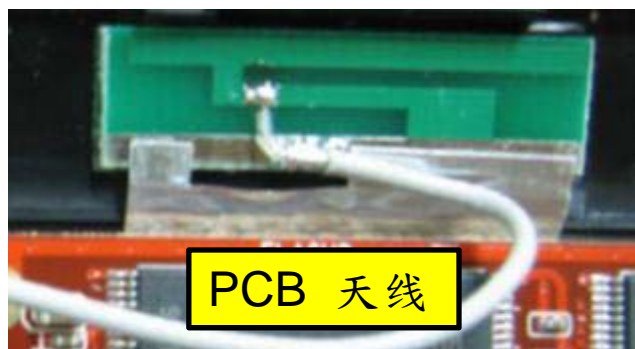
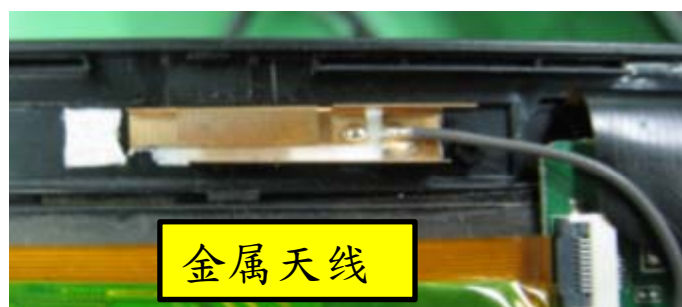
2.45GHz\_E-plane



- ❖ 下表为一个陶瓷天线 (Chip antenna) 的实体图及规格表，由于此天线带宽过窄，增益也未达标准，此种规格的天线就不建议使用。建议使用金属天线，软板天线或 PCB 天线，上述的天线带宽通常都较宽，效率也较好。



Center Frequency 中心频率	Impedance 特性阻抗	Bandwidth* 带宽	Gain* 增益	VSWR 电压驻波比	Polarization 极化
2450 MHz	50 Ohms	~80 MHz	0 dBi	2.0 max	Linear



❖ 在组装天线时，有以下几点需注意：

- 天线的馈线在剥线时，切勿剥除过多的屏蔽网，导致50欧姆阻抗不连续。

--目的：提高馈线50欧姆的连续性，防止信号反射。

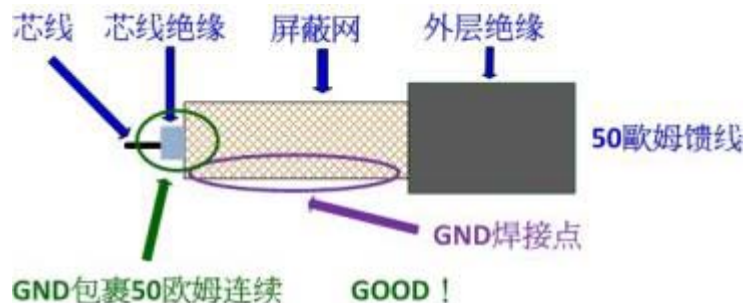
- 天线的馈线走线不可跨越板子上的电源走线以及时钟走线。

--目的:避免板子上的杂讯透过天线馈线辐射出去或是杂讯经由天线馈线跑进模块的RF输入端。

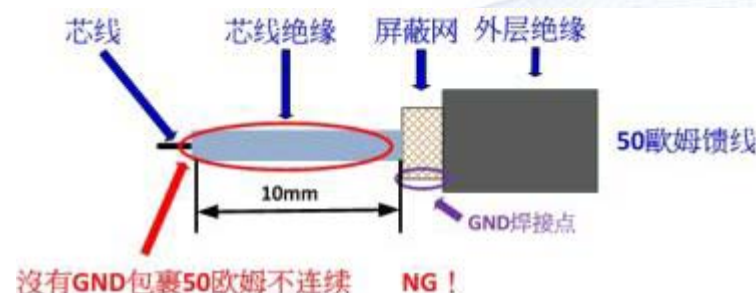
- 天线的馈线走线切勿过长，过长的馈线会造成过多的RF能量损失，建议馈线长度需小于7公分。



正确的馈线剥线方式



错误的馈线剥线方式



Referred to IPC/JEDEC standard.

Peak Temperature :  $<250^{\circ}\text{C}$

Number of Times :  $\leq 2$  times

## SMT reflow profile 参数值

需使用氮气N2, 含氧量建议为1500+/-500 ppm

